



您的位置: 首页 > 行业资讯 > 行业动态

行业动态

市场走势

技术前沿

政策法规

## 达利凯普高端电子元器件产业化项目正式竣工投产

2022-08-01 来源: 半岛晨报 浏览次数: 296

加关注

365



分享至:



7月21日, 大连达利凯普科技股份有限公司高端电子元器件产业化项目竣工典礼暨投产仪式于金普新区举行。该项目的竣工投产, 标志着达利凯普规模与产能的进一步扩大, 为金普新区打造千亿级电子信息产业集群注入新的动能。

据悉, 达利凯普高端电子元器件产业化项目是辽宁省数字产业化重点建设项目, 列入辽宁省三篇大文章 "新字号" 重点项目, 对国产射频微波陶瓷电容器(射频微波MLCC)替代进口、解决"卡脖子"问题以及推动产业数字化发展具有重要意义。该项目总建筑面积5.6万平方米, 其中一期建筑面积3.7万平方米, 投资金额超过3.3亿元, 项目投产将实现年产射频微波瓷介电容器30亿只, 逐步满足国内5G通信、航空航天等重点领域国产替代的急迫需求, 对推动我国电子信息产业化的发展和地区产业链、供应链建设具有战略意义。

上一篇: [金力永磁拟15415万元收购银海新材](#) 下一篇: [Q4消费类MLCC或严重供过于求](#)

地址: 北京市石景山路23号中础大厦B座710室 电话: 010-68638969

网站邮箱: [iccca@ic-ccca.org.cn](mailto:iccca@ic-ccca.org.cn) 京ICP备12052994号-1 京公网安备110107000141 宣传服务